																		Τ				
Дубл.																						
Замісп	ЛЬ																					
Підпис	:																	<u> </u>				
																					-	
A	Цех								Позничення							я документу						
Б	Код.назва обладнання							CM	Т	Троф	Р	УT	KP	KOI		OH	оп	КШТ	т пз	ТШТ		
K-M	Назва деталі.скл одиниці або матеріалу							Позначення.код								СПП	OB	OH	КВ	H Bump		
01	8	Рези	стор	C2-23-0.	25-22k0m	1 +-5%	ОЖО.46	7.180T	J (1wm)										796	100	100	
02	9	Рези	стор	C2-23-0.	0,25-47кОм +-5% ОЖО.467.180ТУ (1шт)														796	100	100	
03	10	Рези	стор	C2-23-0.	0.25-10кОм +-5% ОЖО.467.180ТУ (1шm)														796	100	100	
04	11	Діод	и КД	522 Д33.3	22 Д33.362029ТУ (Зшт)														796	100	300	
05	12	Тран	ізист	mpp KT160AM AA0336335TY (1mm)															796	100	100	
06																						
07																						
08																						
09																						
10																						
A 11	402		12	045	402 12 0	145.Паян	ня															0,005
Б 12		Уст	тновк	α παῦκυ :	хвилею А	∃6-80 P	Д 123-6	54														
0 13		Ππαι	nu na	яти noTT	П 881 111	(45wm)																
T 14		Кусс	чки (РТ789 987 , Пінцет РТ987 789																		
M 15		Приг	ой П	DCT 61 F	DCT 21921	-76													180	100	1,32	
16		Флю	- ΦΚΙ	п гост	4866-54														180	100	1,32	
17		СРС	гост	5987-57															180	100	1,32	
18																						